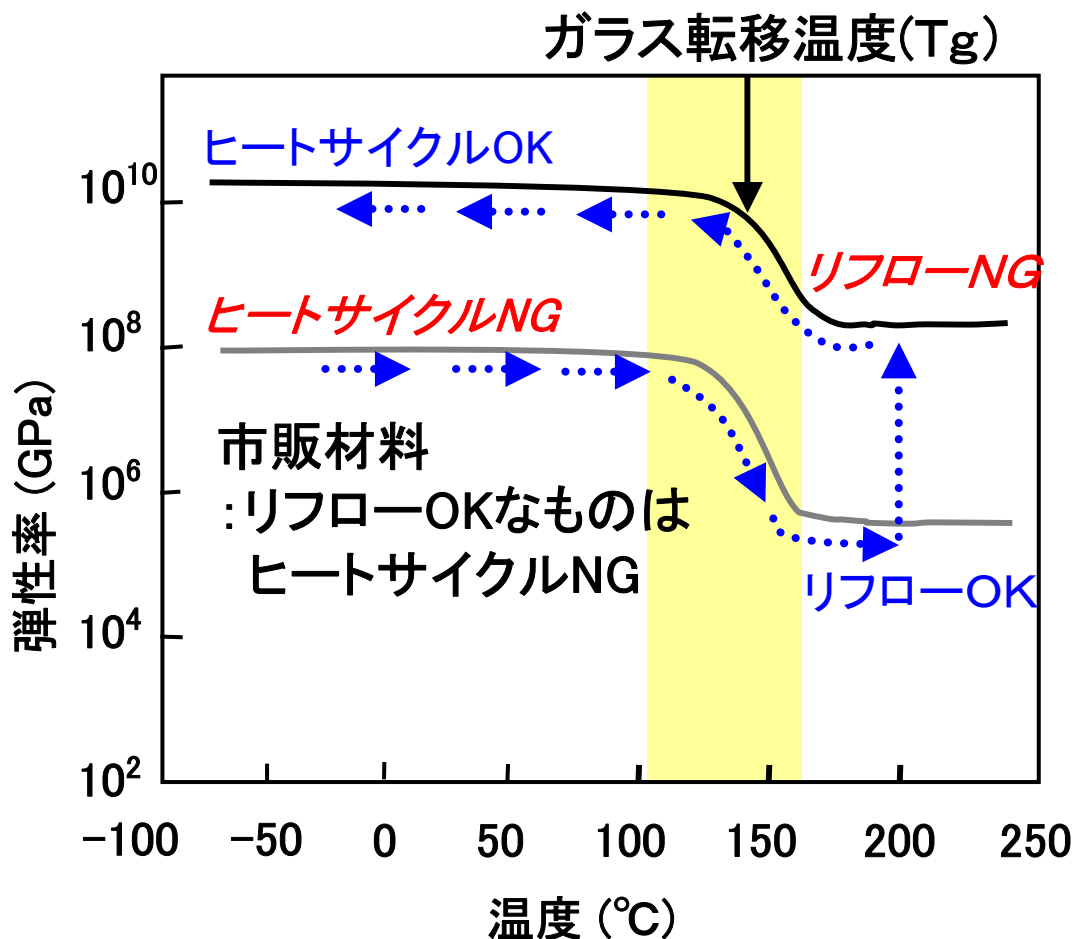


ベアチップ実装(はんだバンプ)用アンダーフィル

—二段階硬化型接着剤—

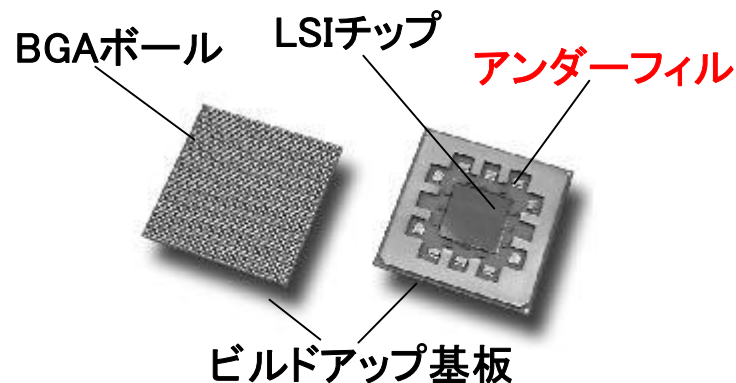


リフロー、ヒートサイクルを両立する理想的な材料なし！(皆苦労)

二段階硬化型材料を開発

1st: 第一樹脂が硬化
(リフロー時低弾性)

2nd: 第二樹脂が硬化
(室温に戻った時高弾性)



低コスト樹脂基板パッケージに実用化

Nobuhiro Imaizumi etc, "New Under-fill Adhesive for Flip Chip BGA",
2004 Proceeding "Pan Pacific Microelectronics Symposium", pp45-50(2004)